

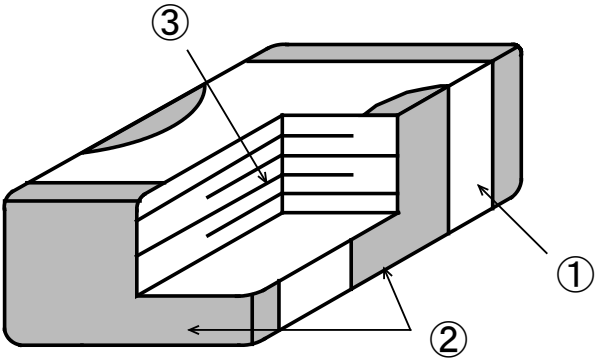
低 ESL チップ積層セラミックコンデンサ 構造図および材料表

Structure and Material of Low ESL Chip Multilayer Ceramic Capacitors

<LLD Series>

(Except for LLD155***755/915/106)

1.内部構造/Structure



2.材料名/Material

	名称/Name	材料/Material
①	誘電体素子 Dielectric layer	チタン酸バリウム系 Barium titanate-based
②	外部電極 Outer electrode	銅 + ニッケルめっき + すずめっき Cu + Ni plating + Sn plating
③	内部電極 Inner electrode	ニッケル Ni

J(E)MCZ0-1R1437

<ご参考> 当社ウェブサイトにて、各シリーズの最新の構造図を入手いただくことが可能です。 → [構造図/材料表](#)

<Reference> The latest structure diagrams of each series are available on our website. → [Structure diagram, Materials chart](#)